




Articles ▶ Trimble au salon BIM World 2017



 Albet Véronique 07 mars 2017

  Ajouter des médias  Ajouter aux favoris

Thèmes Actualité • Événement

## L'interopérabilité des solutions TRIMBLE en OPEN BIM & La réalité augmentée pour explorer les projets MEP

Trimble annonce le renouvellement de son partenariat avec BIM WORLD pour l'édition 2017 -l'événement promoteur de la transformation digitale pour la construction, l'immobilier et l'aménagement urbain- qui se déroulera les 29 et 30 mars 2017 à Paris La Défense, Espace Grande Arche. Lors de cet événement, le stand Trimble Buildings regroupera les entités Trimble MEP, Trimble Structure, Vianova Systems France pour la conception des infrastructures ainsi que SketchUp.

Afin de mettre en avant l'interopérabilité de ses solutions, des **démonstrations du workflow d'un modèle BIM de projet réalisé avec les solutions du groupe Trimble** seront effectuées sur le stand.

Par ailleurs, les visiteurs pourront découvrir **la solution SketchUp Viewer pour Microsoft HoloLens**. Ils auront l'opportunité **d'explorer des constructions et projets MEP en réalité augmentée** ! Une solution inégalée pour analyser rapidement différents scénarios de conception ou pour permettre à des équipes distantes de revoir leurs projets et de collaborer efficacement en temps réel.

Enfin, Trimble Buildings présentera un portefeuille complet de solutions logicielles qui couvre l'ensemble du cycle de vie d'un bâtiment 'Conception - Construction - Maintenance' (DBO). Trimble mettra en avant l'interopérabilité de ses solutions OPEN BIM : SketchUp pour l'Architecture, Tekla pour la Structure, Plancal nova pour les Fluides, Vianova pour les Infrastructures Civiles ainsi que Trimble Connect pour l'Echange et la Collaboration.

<http://buildings.trimble.com>